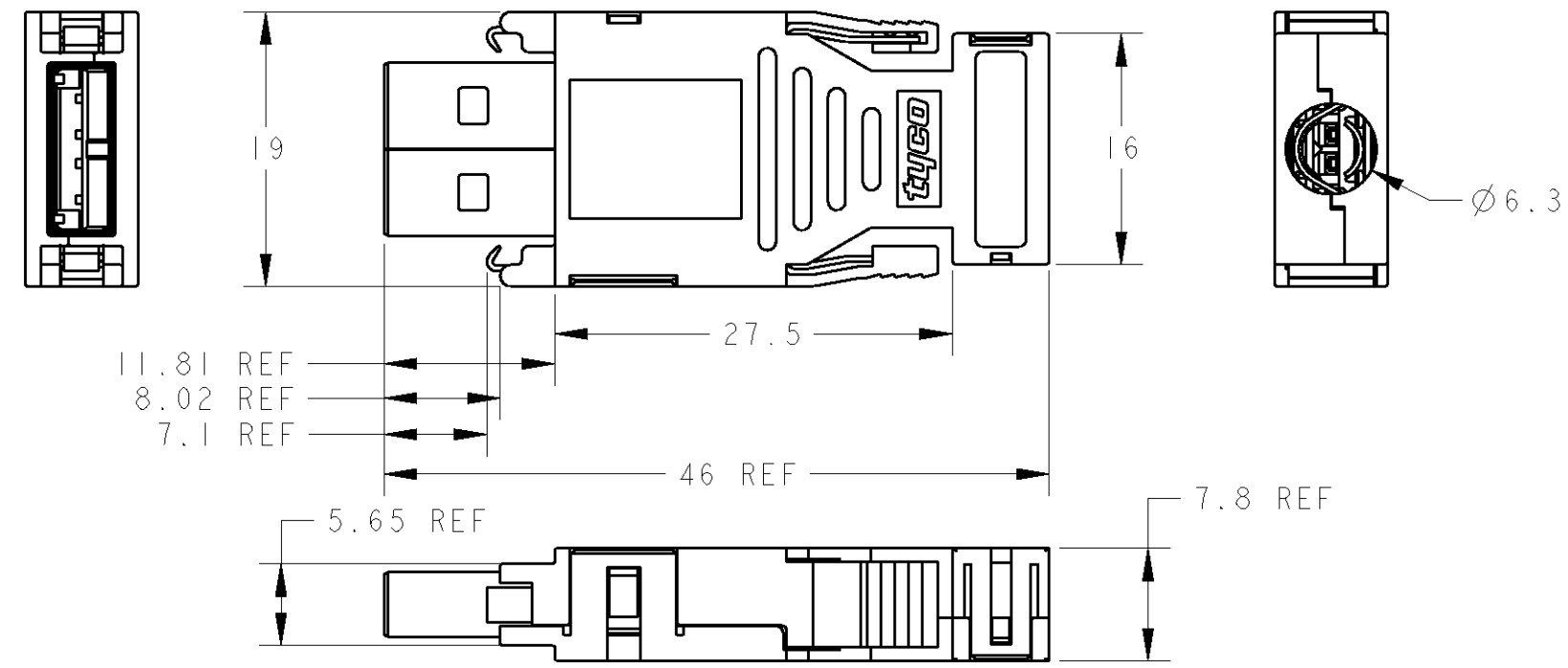
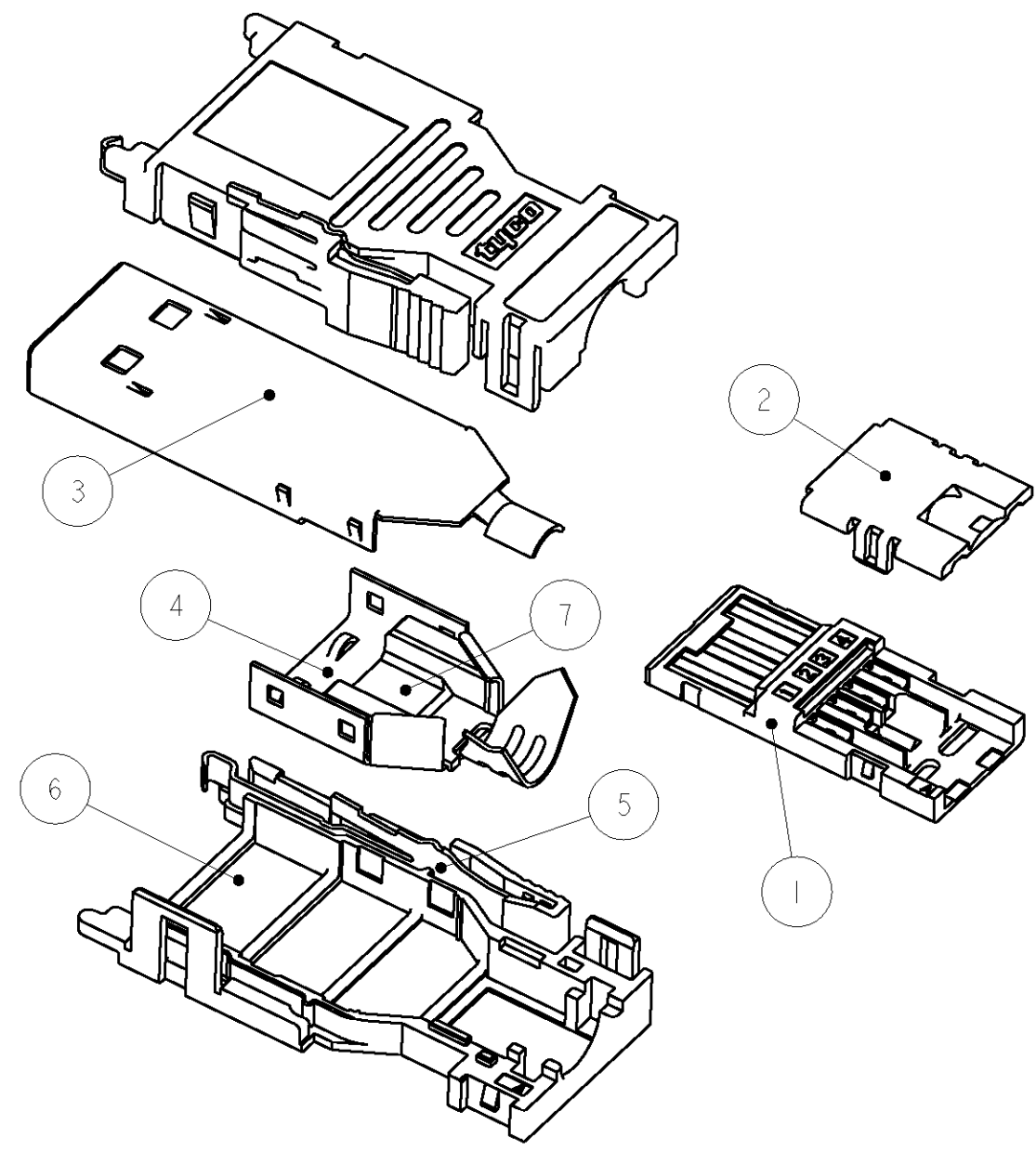


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
 RELEASED FOR PUBLICATION
 20
 © COPYRIGHT 20 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	-		A	RELEASED	21DEC2007	S. I	I. H
			B	REVISED	22MAY2008	S. I	I. H



- 1 : 本図
 - 1 : AS SHOWN



ITEM NO.	MATERIAL/FINISH	PART NAME	ITEM NO.
1	POLYAMIDE OF GLASS FILLED PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリアミド系樹脂 UL94V-0	RETENTION HSG リテンション ハウジング	7
2	OLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入り熱可塑性ポリエステル系樹脂 UL94V-0	COVER HSG カバー ハウジング	6
2	STAINLESS STEEL ステンレス鋼	LOCK SPRING ロック スプリング	5
1	STEEL/UNDER:COPPER PLATING, TOP:Ni PLATING 鋼/下地:銅めっき, 表面:ニッケルめっき	BACK SHELL OF PLUG バック シェル	4
1	STEEL/UNDER:COPPER PLATING, TOP:Ni PLATING 鋼/下地:銅めっき, 表面:ニッケルめっき	FRONT SHELL OF PLUG フロント シェル	3
1	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入り熱可塑性ポリエステル系樹脂 UL94V-0	CAP HSG キャップ ハウジング	2
1	CONTACT(COPPER ALLOY/ UNDER ALL SURFACE:Ni PLATING 1.27 μ m MIN TOP CONTACT AREA:Au PLATING 0.76 μ m MIN SOLDERING AREA:Tin PLATING 2 μ m MIN) HSG(POLYAMIDE OF GLASS FILLED PLASTIC(UL94V-0)) コンタクト(銅合金/ 全面:ニッケルめっき下地 1.27 μ m以上 表面 接点部:金めっき 0.76 μ m以上 半田付け部:錫めっき 2 μ m以上) ハウジング(ガラス入りポリアミド系樹脂 UL94V-0)	PLUG HSG ASSY プラグ ハウジング アセンブリ	1
REQUIRED PAR ASSEMBLY	MATERIAL/FINISH 材料/仕上げ	PART NAME 部品名称	ITEM NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION
 IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
 SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DWN S. INOMATA	21DEC2007	Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan	NAME INDUSTRIAL USB PLUG CONNECTOR KIT
CHK I. HASEGAWA	21DEC2007		
APVD I. HASEGAWA	21DEC2007		
PRODUCT SPEC 108-78523			
MATERIAL -	FINISH -	APPLICATION SPEC 114-5434	RESTRICTED TO -
DIMENSIONS: 単位: 概 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ± 0.3	
		WEIGHT 29.9(g)	SCALE 2:1
MATERIAL		SIZE A3	CAGE CODE 00779
FINISH		DRAWING NO C-2013798	SHEET 1
MATERIAL		REVISIONS	REV B
FINISH		CUSTOMER DRAWING	OF 1